

ファインパターン対応ビアフィリング用硫酸銅めっき添加剤

トッフルチナNSV

For Fine Patterns Additives for Acid Copper Plating to Via-filling

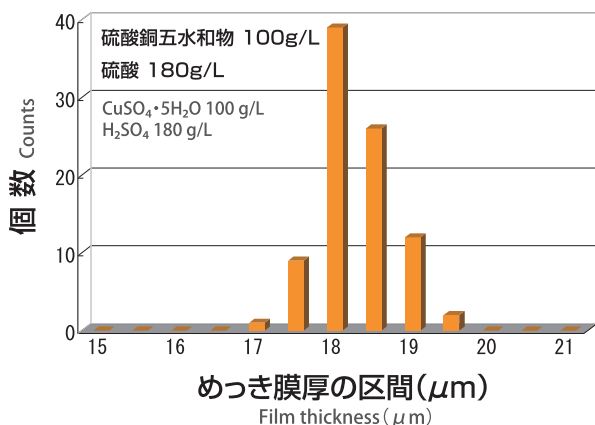
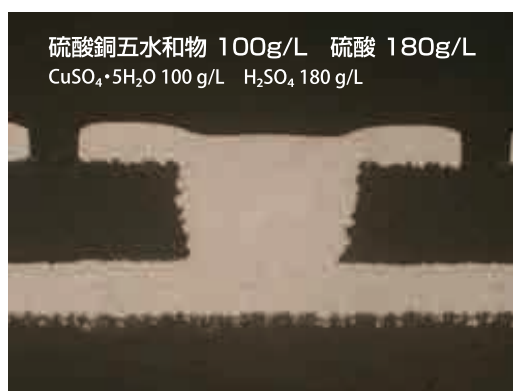
TOP LUCINA NSV

- パターン疎密によるめっき膜厚のバラツキが小さい
- ブラインドビアホールへのフィリングが可能
- 熱衝撃性に優れた高展延性の皮膜が得られる
- 緻密で平滑な光沢外観が得られる

- Reduce thickness variation by density of pattern
- Blind via holes can be filled
- Give high ductility, excellent in thermal shock resistance
- Fine, smooth, bright appearances can be obtained

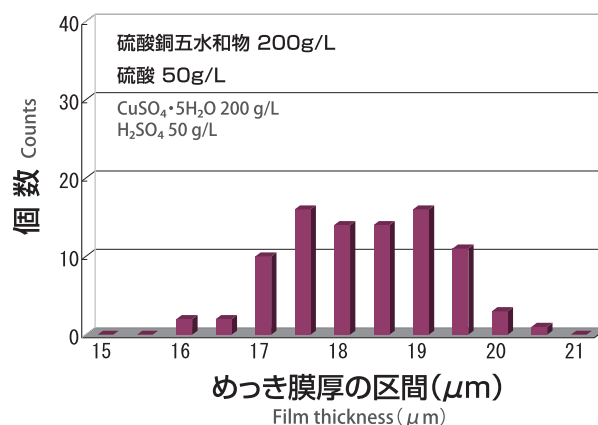
トッフルチナNSV

TOP LUCINA NSV



従来浴

Conventional bath



トッフルチナNSV パターン形状

TOP LUCINA NSV Shapes of patterns

